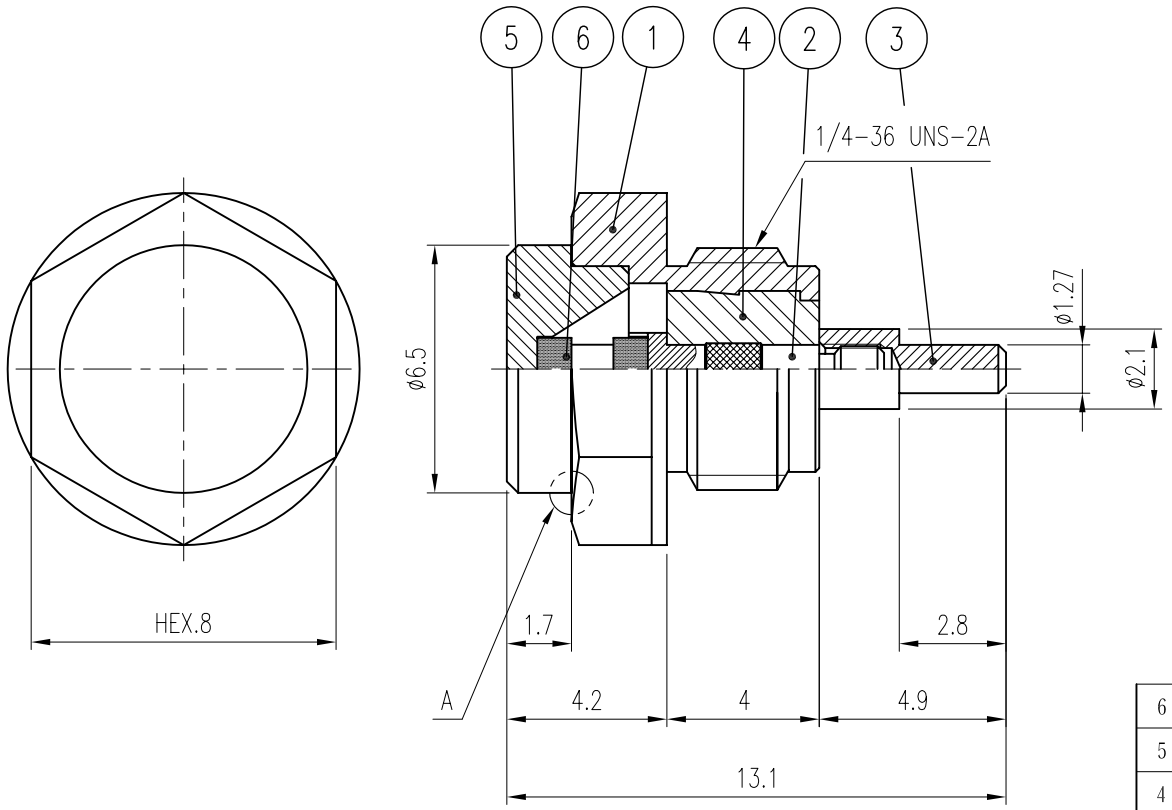
가공 / ST									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



조 립 주 기

1. 절연체에 PIN을 밀어 넣어 조립한다.
2. 조립된 절연체를 BODY에 끼운다.
3. 저항을 삽입한다.
4. COVER를 억지끼움한다. <표시 A부분 밀착 시킬 것.>
5. 4번까지 조립된 상태에 3번 PIN을 나사 체결 후 PIN 길이를 확인한다.
   (LOC TITE를 바른다.)
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.
   <저항값 48~52Ω>

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00068-5/1 (L2044)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01311-N/1
3	CONTACT(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01563-5/1
2	CONTACT(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01562-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD02037-5/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2008. 6. 2.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 2/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-J-내장형TERM

A4

도번 TM00027-7/1